

**СТАНДАРТЫ IPC, ОПИСЫВАЮЩИЕ
ТРЕБОВАНИЯ К ПЕЧАТНЫМ ПЛАТАМ,
ЭЛЕКТРОННЫМ БЛОКАМ, КОМПЛЕКТАЦИИ И ПР.
ПРИ РАБОТЕ ПО БЕССВИНЦОВЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ**

1. IPC J-STD-001D «Требования к пайке электрических и электронных сборок» (Requirements for Soldered Electrical and Electronic Assemblies).
2. IPC-A-610D «Критерии качества электронных сборок» (Acceptability of Electronic Assemblies).
3. IPC/WHMA-A-620A «Требования по монтажу и креплению кабелей, проводов и шлейфов» (Requirements and Acceptance for Cable and Wire Harness Assemblies).
4. IPC-EA-100-K «Справочный комплект по сборке электроники» (Electronic Assembly Reference Set).
5. IPC-M-109 «Сборник стандартов по работе с компонентами» (Component Handling Series).
6. IPC/JEDEC J-STD-020C «Классификация чувствительности к влажности / пайке для негерметичных твердотельных компонентов поверхностного монтажа».
7. IPC/JEDEC J-STD-020C «Классификация чувствительности к влажности / пайке для негерметичных твердотельных компонентов поверхностного монтажа».
8. IPC-7351 «Стандарт: Общие требования по конструированию контактных площадок и печатных плат с применением технологии поверхностного монтажа» (Generic Requirements for Surface Mount Land Pattern and Design Standard).
9. IPC-9701A «Методы испытаний для определения характеристик паяных соединений и требования к проведению испытаний».
10. IPC/JEDEC-9702 «Испытания на изгиб паяных соединений компонентов и печатных плат» (Monotonic Bend Characterization of Board-Level Interconnects).
11. IPC-9704 «Руководство по испытаниям на растяжение печатных плат» (IPC/JEDEC Printed Wiring Board Strain Gage Test Guideline).
12. IPC/EIA/JEDEC J-STD-002B «Тесты на паяемость выводов компонентов, контактных поверхностей и проводов» (Solderability Tests for Component Leads, Terminations, Lugs, Terminals and Wires).
13. IPC/EIA/JEDEC J-STD-003A «Тесты на паяемость печатных плат» (Solderability Tests for Printed Boards).

14. IPC-TR-585 «Климатические испытания финишных покрытий печатных плат» (Time, Temperature and Humidity Stress of Final Board Finish Solderability).
15. IPC-4552 «Спецификация на покрытие контактных площадок печатных плат иммерсионным золотом поверх электролитического никеля» (Specification for Electroless Nickel/Immersion Gold (ENIG) Plating for printed Circuit Boards).
16. IPC-4553 «Спецификация на покрытие контактных площадок печатных плат иммерсионным серебром» (Specification for Immersion silver Plating for printed Circuit Boards).
17. IPC-4101B «Технические характеристики материала основания для жестких и многослойных печатных плат» (Specification for Base Materials for Rigid and Multilayer Printed Boards).
18. IPC J-STD-004A «Требования к флюсам для пайки» (Requirements for Soldering Fluxes).
19. J-STD-005 «Требования к паяльным пастам» (Requirements for Soldering Pastes).
20. IPC-HDBK-005 «Руководство по оценке паяльных паст» (Guide to Solder Paste Assessment).
21. J-STD-006B «Требования к сплавам припоев для электроники и к припоям с содержанием и без содержания флюсов» (Requirements for Electronic Grade Solder Alloys and Fluxed and Non-Fluxed Solid Solders).
22. IPC J-STD-030 «Руководство по выбору и применению материала заливки для компонентов Flip Chip и других микросборок» (Guideline for Selection and Application of Underfill Material for Flip chip and Other Micropackages).